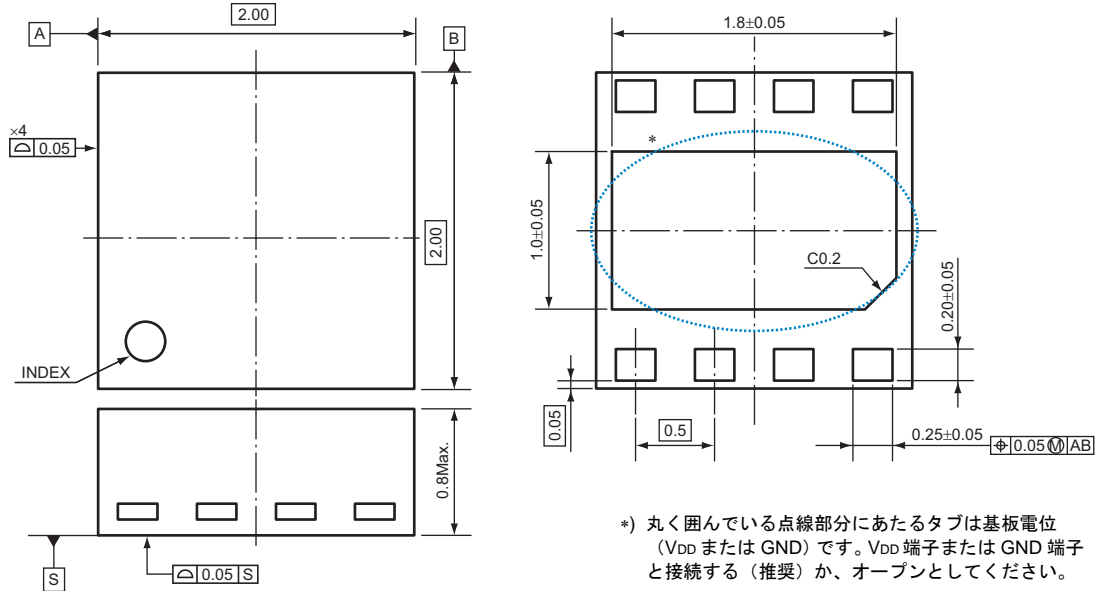


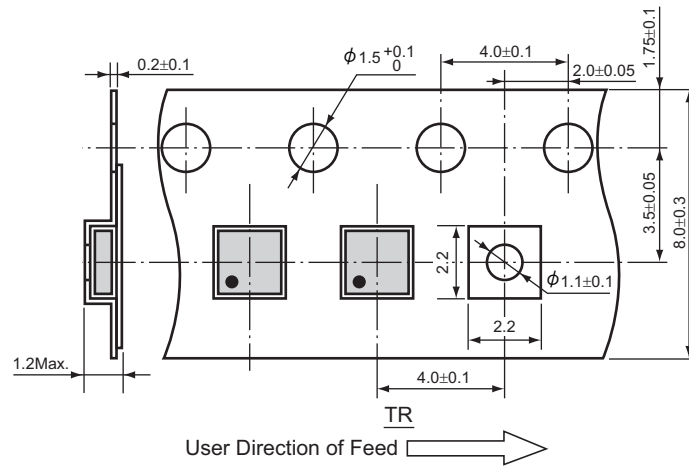
DFN2020-8

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

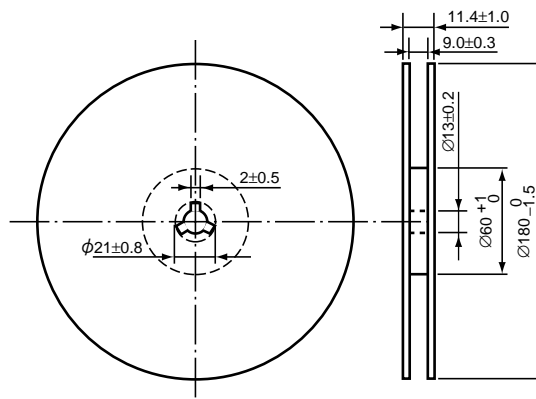


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール(EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=3000 個)



■ 許容損失について (DFN2020-8)

DFN2020-8パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

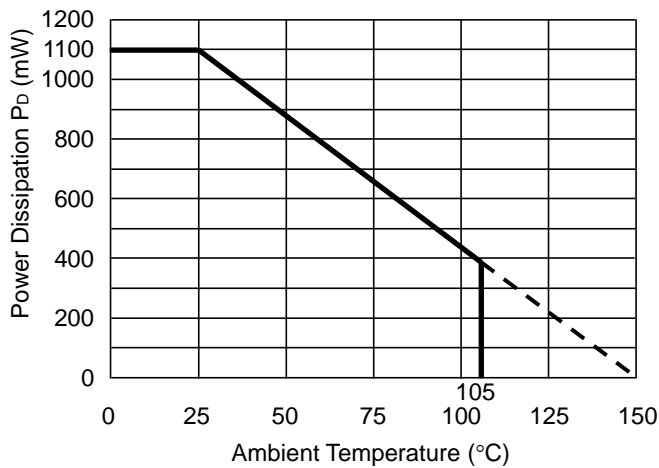
測定条件

標準実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40 mm × 40 mm × 1.6 mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.54 mm × 30 個

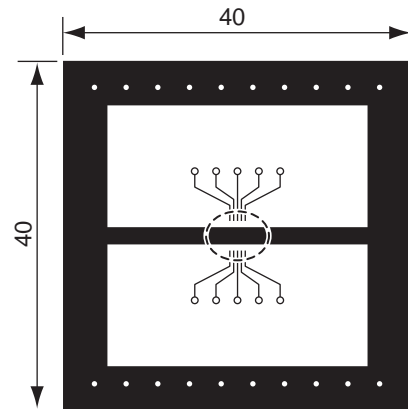
測定結果

(Ta=25°C, Tjmax=150°C)

標準実装条件	
許容損失	1100 mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (150^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) / 1.1\text{W} = 114^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 22.8^\circ\text{C/W}$



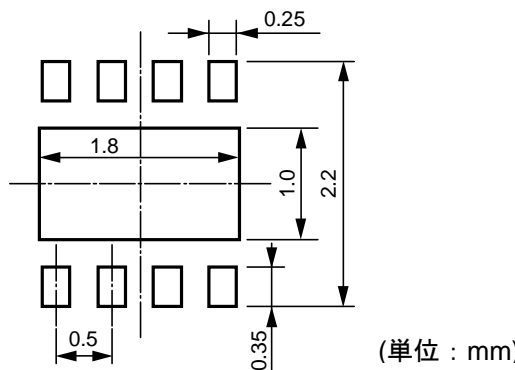
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC実装位置 (単位: mm)

■ 基板パッド推奨寸法 (DFN2020-8)



(単位: mm)